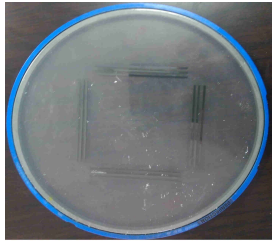


研磨膠帶 BG170



全科 BG170，是晶片研磨專用的膠帶。可以讓晶片在研磨過程不受傷。研磨之後取下不殘膠。

符合 **RoHS** 要求。

物性：

編號	BG170
基材	PO
基材厚度	0.100 mm
中間層	特殊樹脂 SR1
中間層厚度	0.045mm
面膠	特殊樹脂 SR2
上膠厚度	0.025 mm
總厚度	0.170 mm
拉力強度, MD	6.8 kg/in. (53N/20mm)
伸長率, MD	650 %
離型膜	0.05mm PET 離型膜
Adhesion, to SUS	280 g/in. (2.4N/20mm)
長度	50M

儲存要領：請儲放於陰涼乾燥、不可照射到陽光的處所，6個月以內用完。